

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2025-027

深南电路股份有限公司 2025 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深南电路	股票代码	002916
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张丽君	谢丹	
办公地址	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼	
电话	0755-86095188	0755-86095188	
电子信箱	stock@scc.com.cn	stock@scc.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	10,453,454,733.49	8,321,016,212.48	25.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,360,017,775.49	987,300,206.62	37.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	1,265,476,647.45	904,057,388.45	39.98%

利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,495,526,343.91	1,398,768,459.51	6.92%
基本每股收益（元/股）	2.04	1.93	5.70%
稀释每股收益（元/股）	2.04	1.93	5.70%
加权平均净资产收益率	9.04%	7.30%	1.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	26,512,148,623.21	25,302,247,864.46	4.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,217,635,732.62	14,617,020,314.27	4.11%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,190	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深天科技控股（深圳）有限公司	国有法人	63.97%	426,489,271	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.14%	14,236,897	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	4,878,662	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.51%	3,416,961	0	不适用	0
富国基金管理有限公司—社保基金 2101 组合	其他	0.40%	2,664,847	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	2,475,645	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	2,147,739	0	不适用	0
中国诚通控股集团有限公司	国有法人	0.30%	2,005,598	0	不适用	0
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	0.29%	1,918,521	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.28%	1,835,418	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

2025 年上半年，全球宏观经济形势复杂多变，区域增长差异显著。联合国发布的《2025 年世界经济形势与展望》中指出，2025 年全球经济增长预计将放缓至 2.4%（2024 年为 2.9%）。宏观环境的不确定性对电子电路产业带来阶段性挑战，但在人工智能技术革新的驱动下，行业显现出结构性增长机会。

在市场拓展方面，公司精准把握 AI 算力升级、存储市场回暖和汽车电动智能化三大增长机遇，通过强化市场开发力度、优化产品结构，提升市场竞争力。在运营管理方面，公司深入推进数字化转型与智能制造升级，通过系统化成本管控，强化成本竞争优势。同时，公司构建了覆盖研发、生产、物流等环节的智能制造体系，实现运营效能的全面提升。在可持续发展领域，公司践行“双碳”战略，建立全生命周期碳管理体系，通过绿色技术创新和节能措施推动低碳转型，实现经济与环境效益的协同发展。报告期内，公司实现营业总收入 104.53 亿元，同比增长 25.63%；归属于上市公司股东的净利润 13.60 亿元，同比增长 37.75%。

（1）印制电路板业务充分把握三大下游市场机遇，驱动收入和利润双增长

报告期内，公司印制电路板业务实现主营业务收入 62.74 亿元，同比增长 29.21%，占公司营业总收入的 60.02%；毛利率 34.42%，同比增加 3.05 个百分点。

通信领域，根据专业机构 Dell'Oro 最新研究，在经历两年的周期性调整后，全球通信市场有所改善。2025 年第一季度全球无线网络接入（RAN）市场实现 2023 年一季度以来的首次增长。有线侧在算力需求的拉动下，400G 及以上的高速交换机、光模块需求显著增长。报告期内，公司凭借行业领先的技术水平与高效优质的服务能力，充分把握行业需求增长机会，无线、有线通信产品订单规模同比均有明显增长。

数据中心领域，2025 年上半年国内外主要云服务商整体资本开支规模持续提升，并且重点用于 AI 算力投资，进而带动了 AI 服务器及相关配套产品的需求增长。报告期内，公司受益于算力基础设施建设加速，AI 加速卡等产品需求释放，带动订单同比取得显著增长，成为 PCB 业务业绩增长的核心驱动力。

汽车领域，根据研究机构 Marklines 数据，2025 年 1-4 月全球新能源汽车销量达 494.7 万辆，同比增长 34.5%，占全球汽车总销量份额达 23.5%。报告期内，公司继续重点把握汽车电子和 ADAS 方向的增长机会，汽车领域相关订单保持快速增长。

报告期内，PCB 业务总体产能利用率处于相对高位，公司针对性开展多项运营管理能力提升工作，通过提升原材料利用率、前置引导客户设计、优化能源管理、部分瓶颈工序技术提效等多种方式，保障高效产出。新项目建设方面，公司积极推进泰国工厂以及南通四期项目的基础工程建设，为后续业务拓展提供支撑。

(2) 封装基板业务聚焦能力建设与市场开发，把握存储等市场增长机会

报告期内，公司封装基板业务实现主营业务收入 17.40 亿元，同比增长 9.03%，占公司营业总收入的 16.64%；毛利率 15.15%，同比减少 10.31 个百分点。

2025 年上半年，全球半导体行业整体销售额在图形处理器、高端 DRAM 等算力相关芯片带动下同比保持增长。WSTS 统计数据显示，截至 5 月，全球半导体销售额累计同比增速已提升至 19.1%，增长主要聚焦于逻辑与存储领域。报告期内，公司封装基板业务牢牢把握国内存储市场增长的机遇，加大市场拓展力度，推动订单较去年同期显著增长。封装基板业务毛利率同比下降，主要由于广州封装基板项目处于产能爬坡阶段，金盐等部分原材料涨价，使得成本及费用较同期增加。

报告期内，公司封装基板业务聚焦能力建设并加大市场拓展力度。BT 类封装基板方面，分应用领域来看：存储类产品，公司得益于前期导入并量产了关键客户新一代高端 DRAM 产品项目，客户需求攀升，带动公司存储产品订单显著增长；处理器芯片类产品，FC-CSP 类工艺实现了技术能力的提升，市场竞争力持续增强，助力业务规模不断拓展；RF 射频类产品，稳步推进新客户新产品导入，并完成了目标产品的稳定批量生产。ABF 类（FC-BGA）封装基板方面，广州新工厂投产后，产品线能力快速提升，产能爬坡稳步推进，公司已具备 20 层及以下产品批量生产能力，22~26 层产品的技术研发及打样工作按期推进中。

(3) 电子装联业务紧抓产业机遇，保持稳健增长

报告期内，公司电子装联业务实现主营业务收入 14.78 亿元，同比增长 22.06%，占公司营业总收入的 14.14%；毛利率 14.98%，同比增加 0.34 个百分点。

2025 年上半年，公司电子装联业务充分把握数据中心及汽车电子领域的需求增长机会，推动营收增长。数据中心领域，公司重点把握算力需求带来的相关机会，深化客户战略协同，并积极推进客户关键项目，带动相关营收明显增长；汽车电子领域，公司继续强化专业产品线竞争力建设，聚焦高价值业务领域。

内部运营上，公司继续依托智能制造与数字化赋能制造过程管理，提升人员效率、保障产品质量。持续优化供应链管理，提升前端辅助设计及后端增值服务能力，加强对客户的一站式服务水平。

(4) 继续加大研发投入，高阶产品技术能力稳步提升

公司长期坚持技术领先战略，以技术发展为第一驱动力，高度重视技术与产品的研发工作，加大研发投入规模，不断提升研发和创新能力。报告期内，公司研发投入占营收比重为 6.43%。公司各项研发项目进展顺利，下一代通信、数据中心及汽车电子相关 PCB 技术研发，FC-BGA 基板产品能力建设，FC-CSP 精细线路基板和射频基板技术能力提升等项目均按期稳步推进。报告期内，公司荣获 2025 年 IPC “Peter Sarmanian 企业荣誉奖”，子公司无锡深南、南通深南获评江苏省先进级智能工厂；公司新增授权专利 38 项，新申请 PCT 专利 7 项，多项产品、技术达到国内、国际领先水平。

(5) 深入推进数字化转型与流程变革，提升经营管理能力

2025 年上半年，公司继续深入推进流程变革与数字化转型工作，深化落实制程、运营、流程、设备、产品等维度的数字化建设，重点提升各监控指标的数据透明化与可视化，进一步提高质量管理能力，促进内部精益改善，减少异常、减少报废、减轻人员负荷、提升生产效率，有效降低相关成本。公司实现多个数字化项目在业务层面的落地应用，加快建设流程型组织，有效支持市场开发和订单交付效率，促进公司经营管理能力及财务成果的综合提升。